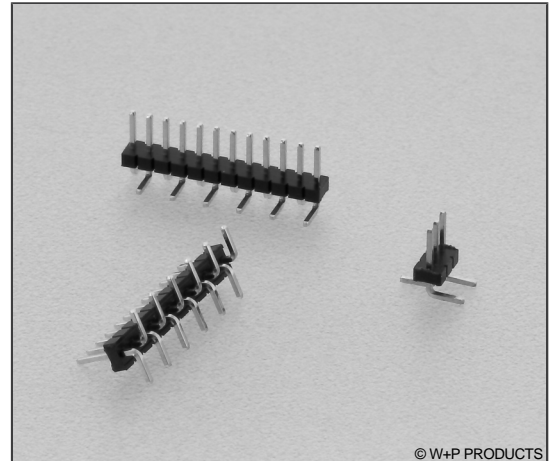


## SMT-Stiftleisten RM 1,27mm, stehend, 1-reihig – 1mm Isolierkörper SMT Pin Headers, 1.27mm Pitch, Vertical, Single Row – 1.0mm Body

### Technische Daten / Technical Data

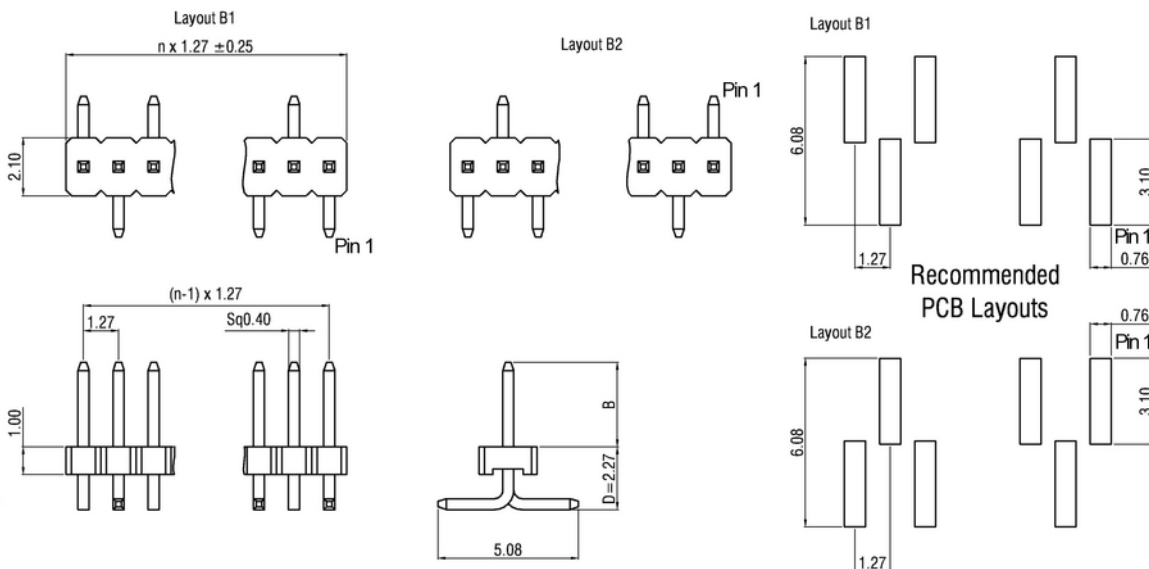
Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,40mm, Kupferlegierung
Contact Material	0.40mm square pin, copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 500MΩ
Insulation Resistance	> 500MΩ
Spannungsfestigkeit	500V <sub>AC</sub>
Test Voltage	500V <sub>AC</sub>
Nennspannung	250V <sub>AC</sub>
Voltage Rating	250V <sub>AC</sub>
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	-40°C ... +105°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:  
Compatible Female Headers:  
**6063** etc.

Weitere siehe Kapitel B  
Please see ch. B for more



Series	Contacts*	Layout*	Dimensions*	Plating*	Packaging*
<b>7140</b>	<b>040</b> 003-050 Einreihig Single row	<b>11</b> 11 Einreihig B1 Single row B1 12 Einreihig B2 Single row B2	<b>10</b> 10 B=3,05mm 99 Kundenspezifisch Customer-specific	<b>00</b> 00 Vergoldet Gold plated 50 Verzinkt Tin plated 60 Sel. Au/Sn Duplex plating	<b>PPST</b> ST PPST PPTR (Option)

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

**Lieferformen / Packaging Options:**  
**ST** In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads  
**PPST** In Stangen mit P&P-Pads / In tubes with P&P-Pads  
**PPTR (Option)** Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

